

Wafer Inspection System - INSPECTRA® Series

半導體業界最快速的晶圓全自動光學檢測設備

- ✓ INSPECTRA® 系列滿足半導體前後段製程高速、高精度的全自動檢測需求！
- ✓ 獨家 Die-to-Statistical-Image 的比較技術可有效降低缺陷檢測過程中造成的損壞及誤判率。



INSPECTRA® 產品資訊

檢測特點

功能	功能優勢	應用效益
高解析度的大範圍檢測	速度快，敏感度高	✓ 良好檢測結果的高生產力
Die-to-Statistical-Image 演算法	達成缺陷檢測目標	✓ 控制流程變異及誤率
多款光學及硬體系統	提供光學檢測解決方案	✓ 適用多種晶圓尺寸及晶圓種類

產品規格

適用晶圓尺寸	缺陷檢出尺寸	應用範圍
2 ~ 12吋矽晶圓 / 帶框晶圓 / 化合物晶圓 / 玻璃晶圓等	> 0.5 μm	正面 / 背面 / 邊緣

應用領域

大規模積體電路(LSI)、影像感測器(CIS)、微機電(MEMS)、LED、凸塊(Bump)、直通矽晶穿孔(TSV)檢測、電源晶片、功率元件(SiC)、氮化鎵(GaN)、化合物半導體

Contact us

 新竹市東區水源街95號
 +886 3 573 8099 #1078
 marketing@spirox.com

